ON Semiconductor®



Title of Change:	Transfer of Wafer level CSP Bump from Deca Technologies to Flip Chip International for the list affected device.		
Proposed First Ship date:	27 May 2020 or earlier if approved by customer		
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <u>Steve.Frost@onsemi.com</u> >		
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <pcn.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.</pcn.samples@onsemi.com>		
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <u>Chielo.Basa@onsemi.com</u> >		
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com		
Marking of Parts/ Traceability of Change:	From Tracecode d (YW) to Tracecode F(YW)		
Change Category:	Wafer Bump site change, Assembly Change		
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer		
Sites Affected:			
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites		
None	Deca Technologies, Philippines		
	Flipchip International, USA		
Description and Purpose:			

Manufacturing Site transfer:

ON Semiconductor would like to inform its customers of the intention to transfer the bumping process from Deca Technologies to Flip Chip International (FCI) for the effected devices listed in this document. These devices are currently bumped at Deca while saw and T&R is performed internally within ON Semiconductor. Upon approval of the final PCN, the effect devices may be bumped at either Deca (until supply is depleted) or at FCI as shown in the table below.

	Before Change Description	After Change Description
Wafer Bump	Deca Technologies	Flip Chip international



Product Marking	From	То
NCP1854FCCT1G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP1855FCCT1G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP398FCCT1G	Tracecode d (YW)	Tracecode F(YW)
NCP456RFCCT2G	Tracecode d (YW)	Tracecode F(YW)
NCP459FCT2G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP6343AVFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP6343BFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP634SFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP6343MFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP6925BFCCT2G	Tracecode d (WLYWW)	Tracecode F(WLYWW)
NCP6356BSFCCT1G	Tracecode d (WLYWW)	Tracecode F(WLYWW)

There is no change to product identification. Only to assembly site code YW= two digit year and work week date code

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: NCP6335/6336

RMS# : \$40230,\$47529,\$45146

PACKAGE : FCDCA

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	168hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	168hrs	0/231
тс	JESD22-A104	Ta= -40°C to + 125°C	500 cyc	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

ON Semiconductor®



List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NCP1854FCCT1G	NCP6335/6336
NCP1855FCCT1G	NCP6335/6336
NCP398FCCT1G	NCP6335/6336
NCP456RFCCT2G	NCP6335/6336
NCP459FCT2G	NCP6335/6336
NCP6343AVFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343BFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343SFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343MFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6925BFCCT2G	NCP6335/6336
NCP6356BSFCCT1G	NCP6335/6336

Japanese translation of the notification starts here. 通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注:日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先さ れます.



文書番号#:FPCN23003X **発行日**:20 Feb 2020

変更件名:	対象製品一覧のウェハレベル CSP バンプ加工拠点を、Deca Technologies から Flip Chip International に移管			
初回出荷予定日:	27 May 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.			
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業	所または < <u>Steve.Frost@onsemi.com</u> > にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <pcn.samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。</pcn.samples@onsemi.com>			
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダク	7ター営業所または< <u>Chielo.Basa@onsemi.com</u> >にお問い合わせください。		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知(FPCN)です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾され たものとみなします。 お問い合わせは、< <u>PCN.Support@onsemi.com></u> 宛てにお願いします。			
変更部品の識別:	トレースコード d (YW) からトレースコード F (YW) に変更			
変更カテゴリ: ウェハバンプ加工拠点	変更カテゴリ: ウェハバンプ加工拠点の変更、アセンブリの変更			
変更サブカテゴリ:製造拠点の移車	変更サブカテゴリ : 製造拠点の移転			
影響を受ける拠点:				
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:			
無し	Deca Technologies, Philippines			

説明および目的:

製造拠点の移転:

オン・セミコンダクターは、本通知にリストした対象製品のバンプ加工を Deca Technologies から Flip Chip International (FCI) に移管することをお客様にお 知らせいたします。これらの製品は現在 Deca でバンプされていますが、ソーイングと T&R はオン・セミコンダクター社内で行われています。 最終 PCN の承認に 応じて、以下の表に示すとおり、対象製品は、Deca (在庫がなくなるまで) または FCI のいずれかでバンプ加工されます。

Flipchip International, USA

プロセス	変更前の表記	変更後の表記
ウェハバンプ	Deca Technologies	Flip Chip international

製品表示変更:

製品表示変更	変更前	変更後
NCP1854FCCT1G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP1855FCCT1G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP398FCCT1G	Tracecode d (YW)	Tracecode F(YW)
NCP456RFCCT2G	Tracecode d (YW)	Tracecode F(YW)
NCP459FCT2G	Tracecode d (YWW)	Tracecode F(YWW)
NCP6343AVFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP6343BFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP634SFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号#: FPCN23003X **発行日**:20 Feb 2020

NCP6343MFCCT1G	Tracecode d (LYWW)	Tracecode F(LYWW)
NCP6925BFCCT2G	Tracecode d (WLYWW)	Tracecode F(WLYWW)
NCP6356BSFCCT1G	Tracecode d (WLYWW)	Tracecode F(WLYWW)

製品識別に関する変更はありません。組み立て拠点コードのみ変更されます。 YW=2 桁の、稼働年と稼働週の日付コード

信頼性データの要約:

デバイス名:NCP6335/6336 RMS# : S40230, S47529, S45146 パッケージ : FCDCA

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	168hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	168hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to + 125°C	500 сус	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
NCP1854FCCT1G	NCP6335/6336
NCP1855FCCT1G	NCP6335/6336
NCP398FCCT1G	NCP6335/6336
NCP456RFCCT2G	NCP6335/6336
NCP459FCT2G	NCP6335/6336
NCP6343AVFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343BFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343SFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6343MFCCT1G	NCP6335/6336
NCP6925BFCCT2G	NCP6335/6336
NCP6356BSFCCT1G	NCP6335/6336



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NCP6343SFCCT1G		NCP6335/6336		
NCP6343BFCCT1G		NCP6335/6336		
NCP459FCT2G		NCP6335/6336		
NCP456RFCCT2G		NCP6335/6336		
NCP398FCCT1G		NCP6335/6336		
NCP1855FCCT1G		NCP6335/6336		
NCP1854FCCT1G		NCP6335/6336		